



半导体材料行业动态跟踪：产业利好政策大力推进 持续看好半导体材料国产化率提升



事件：1月19日，上海市人民政府网站发布了《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(以下简称“《政策》”)。根据政府网站信息，该《政策》于2021年12月21日印发，并于2022年1月1日开始实施。

《政策》条文梳理：

(1) 企业产品研发相关：“对于零部件、原材料等自主研发取得重大突破并实现实际销售的集成电路装备材料重大项目，支持比例为项目新增投资的30%，支持金额原则上不高于1亿元。”“围绕集成电路装备材料等重点领域组织市级科技重大专项。鼓励企业牵头承担国家技术攻关任务，本市按照有关政策，予以配套资金等支持。”

(2) 企业融资相关：“本市国有投资平台企业、相关园区开发平台联合增加对上海集成电路产业投资基金、集成电路装备材料基金募资支持。”“实施本市集成电路优惠利率中长期信贷专项贴息政策，对符合条件的企业并购贷款、债券融资，以及企业为参与集成电路产业投资基金和装备材料基金出资而发行的债券，给予长期优惠利率信贷专项贴息。”

(3) 企业产品验证相关：“加大对自主安全可控装备材料的验证和应用支持力度。

对本市集成电路产线和中试线为本市集成电路首台套装备、首批次新材料验证服务的，给予一定研发补贴。”“将支持自主安全可控装备材料

应用与验证作为本市新建集成电路产线项目获得政府资金支持的基本条件。”

(4) 企业产能建设相关：“加快建设上海电子化学品专区。支持上海电子化学品专区建设，优先布局集成电路材料领域重大产业项目，建设集成电路专用电子化学品公共仓储设施，打造上海电子化学品创新研究院和校企联合实验室。上海化工区专项发展资金进一步聚焦集成电路材料制造、研发、仓储项目，给予一定补贴。”

解读：

全过程给予政策补贴，有效缓解企业资金压力。对于半导体材料企业而言，在其研发、验证、产能建设过程中均需要有大量的资金投入。但是由于以光刻胶为代表的半导体材料的验证周期较长，相关企业难以快速取得产品销售收入，因此在各环节中半导体材料企业都将面临着不小的资金压力。而上述《政策》在研发、验证、产能建设多个阶段均给予了半导体材料企业政策补贴，从而有望有效缓解半导体材料企业在各个阶段内的资金压力，也有利于相关企业对于产品的验证、生产进度的推进，促使相关企业早日取得产品销售收入，实现企业发展的正反馈循环。

加大产业基金支持、拓宽企业融资渠道，出台专项贴息政策降低企业融资压力。我们在1月12日所发布的《大陆晶圆代工厂成熟制程快速扩建，国产光刻胶企业迎来重大机遇——中国化工新时代系列报告之半导体光刻胶》中提及，以国产光刻胶企业为例，当前相关企业的经营性现金流难以

支撑其资本开支的快速增长，因此多数企业考虑通过融资手段来解决资金问题。上述《政策》中所提及的产业投资基金的募资支持以及对企业中长期信贷的专项贴息政策，一方面拓宽了企业的融资渠道，另一方面降低了企业的融资成本。有利于半导体材料企业通过融资手段解决自身研发和产能扩张过程中的资金问题。

政策与市场需求共同作用下，长期看好半导体材料企业快速发展。上述《政策》

符合我国“十四五”规划中所提及的“强化国家战略科技力量”的方针，有利于我国半导体材料企业早日突破“卡脖子”壁垒，避免受制于人的局面再度出现。

此外，从市场需求端来看，根据 SIA 和 BCG 的预测，2020-2030 年期间中国大陆的晶圆代工产能增速将为全球最高，2030 年中国大陆的晶圆代工产能占比将达到全球第一。而从晶圆代工产能的制程结构来看，中国大陆现有的晶圆代工产能和中短期内新增的晶圆代工产能均以成熟制程为主。因此，我们认为中国大陆的晶圆代工产能的制程结构和我国半导体材

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36335

